

DIN EN 60749-20

ICS 31.080.01

Ersatz für
DIN EN 60749-20:2003-12
Siehe jedoch Beginn der
Gültigkeit

**Halbleiterbauelemente –
Mechanische und klimatische Prüfverfahren –
Teil 20: Beständigkeit kunststoffverkappter oberflächenmontierbarer
Bauelemente (SMD) gegenüber der kombinierten Beanspruchung von
Feuchte und Lötwärme (IEC 60749-20:2008);
Deutsche Fassung EN 60749-20:2009**

Semiconductor devices –
Mechanical and climatic test methods –
Part 20: Resistance of plastic encapsulated SMDs to the combined effect of moisture and
soldering heat (IEC 60749-20:2008);
German version EN 60749-20:2009

Dispositifs à semiconducteurs –
Méthodes d'essais mécaniques et climatiques –
Partie 20: Résistance des CMS à boîtiers plastique à l'effet combiné de l'humidité et de la
chaleur de brasage (CEI 60749-20:2008);
Version allemande EN 60749-20:2009

Gesamtumfang 28 Seiten

Beginn der Gültigkeit

Die von CENELEC am 2009-09-01 angenommene EN 60749-20 gilt als DIN-Norm ab 2010-04-01.

Daneben darf DIN EN 60749-20:2003-12 noch bis 2012-09-01 angewendet werden.

Nationales Vorwort

Vorausgegangener Norm-Entwurf: E DIN EN 60749-20:2007-10.

Für diese Norm ist das nationale Arbeitsgremium K 631 „Halbleiterbauelemente“ der DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE (www.dke.de) zuständig. Mit den Nationalen Fußnoten N1) bis N3) weist das DKE/K631 den Anwender dieser Norm auf Übertragungsfehler in der IEC 60749-20:2008 hin, die wegen der Verpflichtung zur unveränderten Übernahme der EN 60749-20 nicht im Text geändert werden dürfen. Die Hinweise wurden auch an die IEC weitergegeben.

Die enthaltene IEC-Publikation wurde vom TC 47 „Semiconductor devices“ erarbeitet.

Das IEC-Komitee hat entschieden, dass der Inhalt dieser Publikation bis zu dem Datum (maintenance result date) unverändert bleiben soll, das auf der IEC-Website unter „<http://webstore.iec.ch>“ zu dieser Publikation angegeben ist. Zu diesem Zeitpunkt wird entsprechend der Entscheidung des Komitees die Publikation

- bestätigt,
- zurückgezogen,
- durch eine Folgeausgabe ersetzt oder
- geändert.

Für den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf eine Norm ohne Angabe des Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die Verweisung auf die jeweils neueste gültige Ausgabe der in Bezug genommenen Norm.

Für den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in Bezug genommene Ausgabe der Norm.

Der Zusammenhang der zitierten Normen mit den entsprechenden Deutschen Normen ergibt sich, soweit ein Zusammenhang besteht, grundsätzlich über die Nummer der entsprechenden IEC-Publikation. Beispiel: IEC 60068 ist als EN 60068 als Europäische Norm durch CENELEC übernommen und als DIN EN 60068 ins Deutsche Normenwerk aufgenommen.

Änderungen

Gegenüber DIN EN 60749-20:2003-12 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- a) Anpassung einiger Klassifikationen der DIN EN 60749-20 an die in IPC/JEDEC J-STD-020C verwendeten Klassen;
- b) Verweis auf DIN EN 60749-35 anstelle auf Anhang A der DIN EN 60749-20:2003;
- c) Überarbeitung bezüglich bleifreier Lötverbindungen;
- d) Berichtigung einiger Fehler in DIN EN 60749-20:2003;
- e) redaktionelle Überarbeitung der Deutschen Fassung.

Frühere Ausgaben

DIN EN 60749-20: 2003-12

Deutsche Fassung

Halbleiterbauelemente –
Mechanische und klimatische Prüfverfahren –
Teil 20: Beständigkeit kunststoffverkappter oberflächenmontierbarer
Bauelemente (SMD) gegenüber der kombinierten Beanspruchung
von Feuchte und Lötwärme
(IEC 60749-20:2008)

Semiconductor devices –
Mechanical and climatic test methods –
Part 20: Resistance of plastic encapsulated
SMDs to the combined effect of moisture
and soldering heat
(IEC 60749-20:2008)

Dispositifs à semiconducteurs –
Méthodes d'essais mécaniques et climatiques –
Partie 20: Résistance des CMS à boîtiers
plastique à l'effet combiné de l'humidité et de la
chaleur de brasage
(CEI 60749-20:2008)

Diese Europäische Norm wurde von CENELEC am 2009-09-01 angenommen. Die CENELEC-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europäischen Norm ohne jede Änderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CENELEC-Mitglied auf Anfrage erhältlich.

Diese Europäische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Französisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CENELEC-Mitglied in eigener Verantwortung durch Übersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CENELEC-Mitglieder sind die nationalen elektrotechnischen Komitees von Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Königreich und Zypern.

CENELEC

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Zentralsekretariat: Avenue Marnix 17, B-1000 Brüssel